**삼성전자 DX부문 현장실습 참가 신청서**

작성일 : 2023. 00. 00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **인**  **적**  **사**  **항** | **성명** |  | **영문성명** |  |
| **생년월일** | 000000 | **희망직무** | SW개발 / 회로개발 / 기구개발 中 택1 |
| **핸드폰** | 010-0000-0000 | **e-mail** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **학**  **력**  **사**  **항** | **구 분** | **입학년월** | **졸업예정일** | **학교명** | **전공** | **재학 학기** | **학점** |
| **대학교** | YYYY.MM | YYYY.MM |  | ※ 주전공, 복수전공 등  이수예정 전공 모두 작성 |  | 0.0/0.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **자**  **격**  **사**  **항** | **특수자격및면허** | **등급** |  | **어**  **학**  **사**  **항** | **영어** | 점(응시명) |  | **특**  **기**  **사**  **항** | **병역구분** | 필/미필/면제/비대상 |
|  |  | **일어** |  | **면제사유** |  |
|  |  | **중국어** |  | **군별** |  |
|  |  | **기타** |  | **보훈여부** | ( Y / N ) |

|  |  |
| --- | --- |
| **지원 동기(500자 이상)** |  |
|  | |
| **장점과 단점(500자 이상)** |  |
|  | |